



即時發表

經辦代理:

David Moreno (大衛穆銳農)

MCA

電話: +1-650-968-8900, 分機 125

電郵: [dmoreno@mcapr.com](mailto:dmoreno@mcapr.com)

## **EBEAM INITIATIVE 擴展 EUV 和奈米壓印 (NIL) 光刻對電子束技術需求教育的努力**

### **佳能 (Canon) 加盟 eBeam Initiative 成為最新會員**

聖荷西，加州，美國，二零一六年二月二十三日—The eBeam Initiative，一個致力於推廣和倡導電子束技術在半導體製造全新應用的團體，今天宣布，2016 年將擴展在教育方面的努力，加強半導體業界對電子束技術要求的認知和對電子束技術新的開發，以支持 EUV 光刻，奈米壓印技術 (NIL)及多重電子束光罩刻寫技術。The eBeam Initiative 假 SPIE Advanced Lithography Conference 會議期間，於今日舉辦的會員和媒體午餐會上，邀請業界專家對上述每個提及的項目進行探討。

同時佳能也成為 eBeam Initiative 新會員公司。佳能的加入，將其在半導體技術領域，尤其是在奈米壓印技術領域的獨特視角和領導力，帶入 eBeam Initiative 已有的 40 多家涵蓋半導體光罩和光刻的整個供應鏈成員組成的大家庭中。

“歡迎佳能加入 eBeam Initiative 成為新的會員。對此，我很高興。” D2S 執行長藤村(Aki Fujimura)先生表示 (D2S 是 eBeam Initiative 的主辦管理公司)。“不管半導體製造採用那一種光刻技術，電子束技術都是必不可少的。佳能在奈米壓印技術的先驅性工作對先進半導體製造技術是相當重要的。就這一點來說，能夠有佳能成為 eBeam Initiative 會員，是令人振奮的。期望佳能支持我們已經在進行的多方合作上的努力，致力於讓人們認識到電子束技術在光罩和半導體工業界的重要性。”

The eBeam Initiative 在去年所做的年度調查中，涵蓋半導體光刻和光罩整個供應鏈的 64 位業界專家回答了調查問卷。調查顯示，大多數回覆者認為在半導體量產中重要層的光罩會在 2018 年底用多重電子束光罩製造機(multi-beam mask writing machines)刻寫。這種期望反應出對多重電子束技術的持續增加的認可—不管在半導體製程中應用那種光刻技術，光罩複雜程度的增加及對電子刻寫精度的需求都形成對多重電子束技術需求的增長。為了支持多重電子束整體技術的發展，以及支持像 EUV 和 NIL 等非傳統次世代光刻技術，the eBeam Initiative 將其教育重心聚焦在這幾項技術領域上。

“經過十年以上的投資和開發，佳能將奈米壓印光刻發展成切實可行的 20-奈米以下高分辨率製程半導體光刻解決方案，” 達格.瑞斯尼克 (Doug Resnick)，佳能奈米技術市場和商業發展副總裁，表示。“能夠在 NIL 模板上刻寫出十幾奈米極高清晰圖案的能力對實現 NIL 作為半導體生產技術的潛能是至關重要的。我們支持像 eBeam Initiative 所做的業界合作嘗試，鼓勵在開放的環境中分享交換訊息和觀念，以便加速電子束技術的發展，這樣不但對奈米壓印光刻技術 (NIL) 有利，也對整個半導體工業有利。”

一年一度的 eBeam Initiative 會員和媒體午餐會將於今天舉行。會上將有業界專家專題講座。題目包括：奈米壓印 (NIL) 主模板製作的挑戰; EUV 和 193-i 光刻在 5-nm 測試晶片設計和製造的比較和挑戰; 和新型多重電子束光罩刻寫機結果驗證。講座內容將會在二月二十三日後發表於 eBeam Initiative 網站上 [www.ebeam.org](http://www.ebeam.org).

**關於 The eBeam Initiative** (電子束倡議團體)

The eBeam Initiative 是一個致力於推廣和倡導電子束技術在半導體製造全新應用的團體；為有關電子束技術的教育和促進活動提供相應的論壇。The eBeam Initiative 的目標是增加電子束技術應用在半導體製造各領域中的投資；降低電子束技術應用的障礙，能夠使更多集成電路設計完成，並且更快投進市場成為可能。

會員公司， 涵蓋整個半導體生態系統，包括:aBeam Technologies; Advantest;Alchip Technologies; AMTC;Applied Materials;Artwork Conversion;AseltaNanographics;Cadence Design Systems;Canon;CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing;EQUIcon Software GmbH Jena;eSilicon Corporation;Fraunhofer CNT; Fujitsu Semiconductor Limited;GenISys GmbH; GLOBALFOUNDRIES;Grenon Consulting;Hitachi High-Technologies; HOLON CO., LTD.;HOYA Corporation;IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG;JEOL; KLA-Tencor;Maglen;Mentor Graphics Corporation;Multibeam Corporation;NCS;NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography;Photronics; Sage Design Automation;Samsung Electronics; STMICROELECTRONICS; Synopsys;tau-Metrix;Tela Innovations; TOOL Corporation; Toppan Printing;Toshiba;Vistec Electron Beam GmbH;Xilinx and ZEISS.

The eBeam Initiative 歡迎所有電子工業的公司和協會加盟。細節請查看 [www.ebeam.org](http://www.ebeam.org).

###